

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 线上交流 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	中泰证券、海通证券、兴业证券、贝莱德、中信证券、华源证券、平安证券、山西证券共 8 家机构。
时间	2025 年 1 月 15 日-2025 年 3 月 18 日
地点	现场交流、公司会议室
形式	现场会议、线上交流
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李妍君
交流内容及具体问答记录	一、公司概况 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。 二、问答环节 1、请简要介绍 2024 年行业发展概况 2024 年半导体行业基本结束了前几年低迷态势，正式进入

	“硅周期”上行阶段，根据 WSTS 统计数据，2024 年前三季度全球半导体销售额合计 4,450 亿美元，同比增长 18.6%。主要受到 AI 算力需求和存储芯片价格回升驱动。国内集成电路产业出现了成熟制程达产率稳步提高、竞争日趋激烈，但高端芯片制造产能和能力尚待进一步提升的态势。 具体到公司所处的 EDA 和晶圆级测试设备领域，2024 年至今无论是在技术革新还是市场发展上，总体态势良好，预计未来国产软硬件将会迎来更多发展机遇。主要受以下几点因素驱动： （1）政策支持：近年来各级政府出台系列政策，支持半导体及信创产业发展，鼓励软硬件产品自主可控； （2）AI 等新技术驱动：生成式 AI 及开源模型兴起，预计 AI 的普及率将大幅提升，推理及算力芯片市场广阔； （3）国产替代：贸易摩擦加剧，高端芯片或需回国流片，国内晶圆厂先进制程的技术开发与产能扩张需求紧迫。 公司所处行业发展前景广阔，也是我国半导体产业发展及智能世界构建不可或缺的一环，未来公司仍将坚定投入研发，持续打造国内乃至国际领先的产品，推动国内外市场开拓，从“小而美”公司成长为具有世界影响力的平台型 EDA 企业。 2、AI 和大模型是当前技术领域热点，请问 2024 年公司在该领域有何进展？ AI 技术正被应用在芯片的研发和制造中，在设计阶段，AI 可以通过机器学习算法，提高芯片性能和能效；在制造过程中，AI 用于预测和检测缺陷，优化生产流程，快速提升良率；同时 AI 模型可以分析海量制造数据，找出潜在问题并进行预防性维护。 公司自 2022 年开始已经将 AI 技术应用于公司的半导体大数据分析与管理平台，并在持续深入应用中。2024 年度主要进展： （1）在产品侧，公司 INF-AI 工业智能化集成平台发布，其中 INF-ADC 自动缺陷分类系统功能持续迭代，支持多种复杂业务场景，客户数量显著提升；推出 INF-WPA 晶圆缺陷图案分析系统、
--	--

	iCASE 半导体缺陷异常智能化诊断系统，已在客户处部署使用。 （2）在大模型侧，公司算法基础能力建设完成，半导体大模型平台 SemiMind 完成了从 0 到 1 的搭建，推动软件产品智能化的同时，也赋能内部提质提效。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2025 年 3 月 18 日